

ニッケルレス最終表面処理プロセス

銅上への無電解金めっきプロセス

銅上への無電解パラジウム/金めっきプロセス

トップギルドプロセス / トップパラスプロセス

Final Surface Treatment Process without Nickel Plating

Electroless Gold Plating Process on Copper Circuit

TOP GILD PROCESS

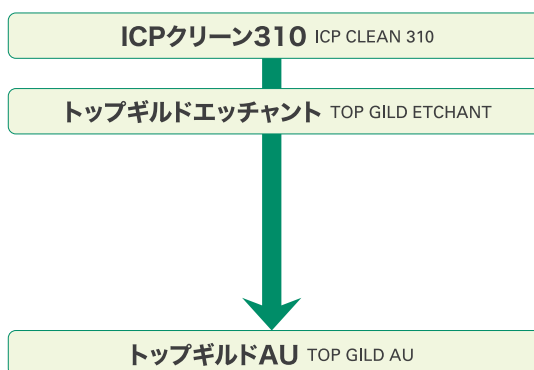
- ▶ 銅上への金析出性が良好
 - ▶ ファインパターン性に優れる
 - ▶ Roll to Roll仕様にも対応
- Good deposition ability of gold plating on copper
 - Excellent fine pattern ability
 - Applicable to Roll to Roll plating system

Electroless Palladium / Gold Plating Process on Copper Circuit

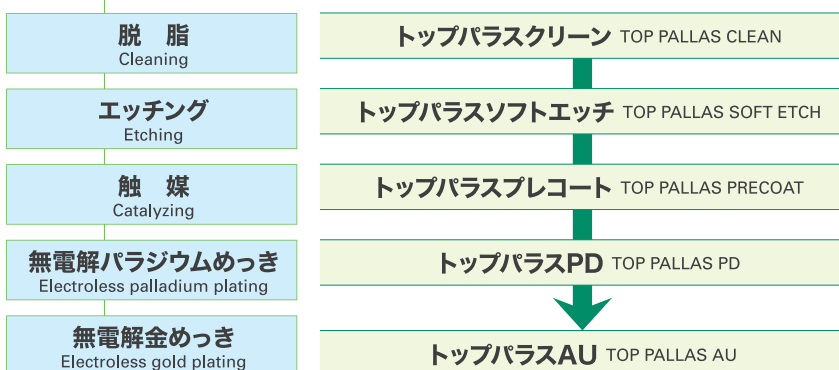
TOP PALLAS PROCESS

- ▶ 銅上へのパラジウム析出性が良好
 - ▶ はんだ接合性、金ワイヤボンディング性に優れる
 - ▶ 耐折性、耐食性が良好
 - ▶ ファインパターン性に優れる
- Good deposition ability of palladium plating on copper
 - Excellent in solder-jointing, gold wire bonding performances
 - High folding endurance, great corrosion resistance
 - Excellent fine pattern ability

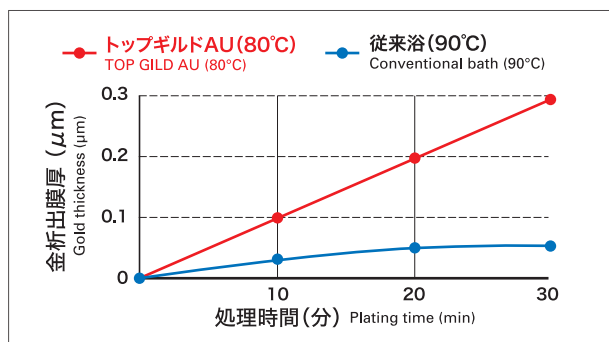
処理工程 Process



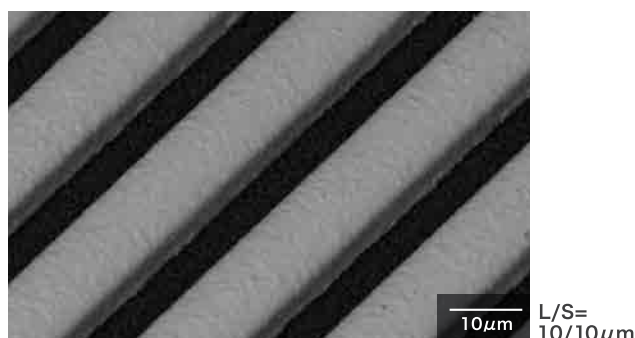
処理工程 Process



良好な析出性 High deposition performance



優れたファインパターン性 Excellent fine circuit pattern ability



優れたはんだ接合性 (ボイドレス) High solder-joint performance with no voids



優れた耐折性 Excellent folding endurance

